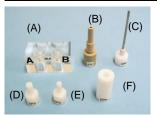
# 013608 DRE-DCP ディスク電極交換研磨ツール



キット内容 (A)DRE-BLK ベースブロック (B)DRE-STP ストッパー (C)DRE-DRS ディスク取出棒 (D)DRE-SPS スペーサー押込棒 (E)DRE-DPS ディスク押込棒 (F)DRE-EPH 電極研磨ホルダー

この商品はディスク交換式電極(DRE)の組立・分解に使用するツール キットです。013336 DRE-PGK、013362 DRE-GCK等の電極は含ま れておりません。

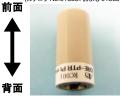
### ディスク交換式電極(DRE)用パーツ注意点

DRE用アッセンブリー、ディスク、スペーサーには前面と背面があ ります。

アッセンブリーはラベル側が背面、電極面が前面になります。 ディスクは背面に面取り加工がされています。

スペーサーは背面に小さな穴(Φ2.5 mm)と面取り加工があります。 組立時は向きに注意してください。逆にして組立てた場合の保証 はできません。

DRE用アッセンブリ-(カタログNo.013337および013361)





DRE-GCD GCディスク



DREの組立は、リングアッセンブリーの前面からディスクを セットする前面組立方法と、背面からディスクをセットする背面 組立方法の両方が行えます。

前面組立方法はディスク電極に前処理を必要としない測定に、 背面組立方法はディスク電極に前処理を行う測定に適してい ます。

# 2.DRE背面組立方法



STP ストッパーを取り付け、DRE-BLK ベースブロックのAにセットします。DRE-SPCテフロンスペーサーをDRE-DPS ディスク押込棒の先端に取り付け、Aの 小穴に慎重に押し入れます。その後



2-2.スペーサーを取り付けた研磨ホルダー をベースブロックのBの大穴に入れます。 GCディスクを背面からBの小穴に入れ、 ディスク押込棒でスペーサー内に挿入し ます。



2-3.DRE-DRSディスク取出棒を研磨ホル ダーに取り付け、ディスクとスペーサー の高さをあわせて研磨します。Ptリング アッセンブリーの研磨は013336 DRE-PGK あるいは013337 DRE-PTRに付 属の取扱説明書をご確認下さい。

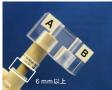


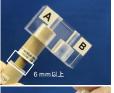
2-4.研磨ホルダーのストッパーをねじ込み ディスクとスペーサーのセットを外します。 ディスクへの前処理はセット状態で行っ てください。前処理したセットを電極面か らアッセンブリーの接続面へ入れます。



2-5. アッセンブリーにストッパーをねじ込み、 ディスクとスペーサーのセットをアッセン ブリー表面の高さを合わせます。ディス クが飛び出した場合はストッパーでセッ トをアッセンブリーから出して再び入れ なおして下さい。

## 1.DRE前面組立方法







- 1-1.DRE用アッセンブリー(013337もしくは 013361)にDRE-STP ストッパーのねじ 部が6 mm以上残る状態で取り付け、 アッセンブリーの前面をDRE-BLKベー スブロックのAの大穴に奥までしっかりと はめ込みます。
- 1-2.DRE-SPC テフロンスペーサー (013339)をDRE-DPS ディスク押込棒 の先端に取り付け、Aの小穴にスペー サーを慎重に真っ直ぐ押入れます。そ の後DRE-SPS スペーサー押込棒を使 いアッセンブリー内に押し込みます。



1-3.アッセンブリーをベースブロックから外し、 DRE-STP ストッパーを装着します。ス トッパーをねじ込みアッセンブリー表面と スペーサーの高さを合わせます。ストッ パーを付けたアッセンブリーをベースブ ロックのBの大穴にはめ込みます。



1-4.DRE用ディスクを背面からベースブロッ クBの小穴に入れます。向きに注意して 下さい。DRE-DPS ディスク押込棒で ディスクをスペーサー内にしっかりとは め込みます。

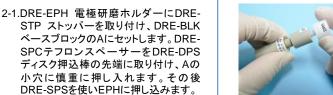


1-5.ストッパーを通してアッセンブリーに DRE-DRS ディスク取出棒を挿入し、電 極表面の高さ調節を行います。

組立てた電極は使用前に研磨してくださ い。研磨方法は弊社ウェブサイトをご確 認下さい。

(https://www.bas.co.jp/polishing.html)

# 3.DRE分解方法





3-1. 電極背面からストッパーをテフロンス ペーサーに接触するまでねじ込みます。 ディスク取り出し棒をストッパーにねじ込 みます。



3-2.ディスク取出棒をねじ込み、ディスク電 極を取出します。



3-3.ストッパーを最後までねじ込みテフロン スペーサーを取り外します。

## ご注意

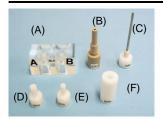
- DREの回転電極測定は回転数範囲を前面組立方法では3000rpm以下、 背面組立方法は2000rpm以下にしてください。それ以上の回転数での測 定は保証できません。
- DRE-SPC テフロンスペーサーは組立、研磨で消耗されます。歪んだ場 合などはすぐに交換して下さい。
- 組立工程でDRE用アッセンブリー、DRE-SPC テフロンスペーサー DRE用ディスクの電極表面の高さがズレた場合、測定結果に悪影響を 及ぼします。
- 前面組立によりバリが発生した場合は背面から組み立てて下さい。 ※2.DRE背面組立方法を参照

カラーのpdfデータや、最新の情報などはホームページからご覧いただけます。

ビー・エー・エス株式会社

https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp



Contents
(A)DRE-BLK Base block
(B)DRE-STP Stopper
(C)DRE-DRS Disk remove tool
(D)DRE-SPS Spacer push tool
(E)DRE-DPS Disk push tool
(F)DRE-EPH Electrode polishing holder

This tool kit is used in order to assemble and/or disassemble the disk replaceable electrode(DRE). assembled and disassembled. DRE-PGK (013336), DRE-GCK (013362) are not included in this kit. They are purchased separately.

#### ATTENTION:

DRE assembly has the rear side with a label and front side for the electrode surface. Disk electrode and spacer also have frontal "electrode side" and back "contact side", respectively.

The disk has chamfering on the "contact side". The spacer has small hole( $\Phi$ =2.5mm) and chamfering. So take care of these details on the time of construction. No guarantee for results coming from reversal construction.

DRE assembly electrode (Cat. No.013337,013361) side

contact







There are two assembly methods for DRE: front assembly & rear assembly. Front assembly: the disk rod is inserted from the "electrode side", which is mainly used for the measurement with no pretreatment for disk rod. Rear assemble: The disk rod is inserted from the "contact side", which can be used for the measurement required for disk surface pretreatment (such as catalyst modification etc.).

# 2.DRE Rear-assembly



2-1.Screw slightly the STP into the DRE-EPH electrode polishing holder. Set the EPH to A big-hole of BLK. Stick DRE-DPS into the hole of DRE-SPC spacer, and put SPC into the hole A with DRE-DPS carefully. Press the SPC into the EPH by the SPS. Then screw the STP to keep the SPC and the EPH surface in same plane.



2-2.Set the EPH to B big-hole of the BLK. Insert the GCD "contact side" to B small-hole of the BLK. Press the GCD into the SPC with the DPS. Then screw the DRS until the SPC and GCD surface are in same plane.



2-3.Polish the disk together with the DRE-EPH Electrode polishing holder linked to the DRE-STP Stopper and DRE-DRS Disk remove tool.

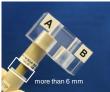


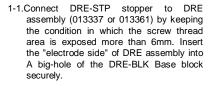
2-4.After polish, remove DRE-DRS firstly, then remove the GCD&SPC set from EPH by screwing the STP. Pretreat the GCD in this state. After GCD pretreatment, insert from the "electrode side" of the GCD-SPC to the "contact side" of the DRE assembly (rear assembly).



2-5.Screw the STP slowly to match the same height of GCD&SPC set to the surface of DRE assembly. If the GCD&SPC set position is higher than the PTR, you have to screw in the STP completely to remove the GCD&SPC set from the DRE assembly, and do assembling 2-4 again.

# 1.DRE Front-assembly







1-2. Fit DRE-DPS Disk push tool into the DRE-SPC Teflon spacer (013339), and insert SPC to the hole A of the base block by pressing DRE-DPS in the axial direction carefully. After that, press the SPC into the DRE assembly with the DRE-SPS Spacer push tool.



1-3.Screw the DRE-STP Stopper until the edge of the SPC is flat to Pt ring surface, then insert the "electrode side" of DRE assembly to B big-hole of the BLK securely.



1-4.Insert the "contact side" of DRE disk to B small-hole of the BLK. Care about the orientation of the GCD. Press the GCD into the SPC with the DRE-DPS.



1-5. Adjust the height of the GC electrode surface by revolving the DRE-DRS Disk remove tool. Polish the assembling electrode before using. (https://www.als-japan.com/1735.html)

## 3.DRE disassembly -



3-1. Screw in the STP until touching the SPC lightly and insert the DRS to the DRE assembly.



3-2. Remove the GCD by screwing the DRS.



3-3.Screw the DRS till the last to remove the SPC.

#### CAUTION

- In order to get the excellent RRDE measurement data, the front assembled DRE should be used for rotation speed lower than 3000 rpm, while rear assembled DRE should be used for rotation speed lower than 2000 rpm. Any applications with rotation speed exceeding above rpm range may possibly cause the unsatisfied RRDE measurement data.
- DRE-SPC Teflon spacer is consumptive material. Please replace SPC if it was distorted.
- If the surface of DRE-GCD, DRE-PTR and DRE-SPC were not in the same plane after assembling process, the RRDE measurement data would be poor.
- In a case of burr formation in Teflon spacer, please try the rear assembly method instead.

Please check color pdf data and the latest information with our website.